附录B

高度控制测量过程有效性确认记录

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程编号 | | 附录A | 测量过程名称 | 密封板装配总厚度测量 | 测量过程规范  编号 | | **Q/XHL001-2014** |
| 所在部门 | | 质量中心 | 测量项目 | 装配总厚度 | 控制程度 | | 高度控制 |
| 测量过程要素概述：  测量设备：（50～75）mm，最大允许误差±0.003mm的数显外径千分尺  测量方法：1.先将数显外径千分尺进行校准   1. 测量密封板装配总厚度尺寸：   ①采用千分尺测量装置厚度（未装夹试样）  ②模具冲取试样 ③将试样按照孔位置放置准确后，夹在两块光滑、平整金属板之间，锁紧螺栓，加力55±5N.m ④30min后，采用数显外径千分尺测量总厚度；⑤计算装配总厚度，测量三个试样，取算术平均值为测量结果。  环境条件：22℃±2℃  测量软件；无  操作者技能：测量设备操作人员，经培训合格。  其他影响量：无 | | | | | | | |
| 有效性确认记录:(采用4等60mm标准量块)  用重复测量法对标准量块测量过程进行有效性确认：  2020年11月15日用50～75mm数显外径千分尺进行重复性再现性检测，对4等60mm标准块进行检测，取三次测量的平均值为60.002mm  （50～75）mm数显外径千分尺的扩展不确定度*U1*为0.007mm；4等60mm标准块*U2*为0.00032mm  =0.33  当E≤1时, 测量过程有效。  确认人员：陈辉霞 日期：2020.11.15 | | | | | | | |
| 变更记录: | | | | | | | |
| 日期 | 变更内容 | | | | | 批准人 | |
|  |  | | | | |  | |
|  |  | | | | |  | |
|  |  | | | | |  | |
|  |  | | | | |  | |